原研(現原子力機構)、理研、専用ビームライン-

BL16B2 (産業界専用BM) 産業用専用ビームライン建設利用共同体

1. はじめに

産業界専用BMビームライン(BL16B2)は、産業界専 用IDビームライン(BL16XU)とともに13企業グループ [脚注1]とJASRIからなる産業用専用ビームライン建設利用 共同体が管理・運営するビームラインであり、サンビーム (SUNBEAM)とも称する。1999年10月より各社利用に供 され^[1]、2003年の専用ビームライン中間評価を経て 2006Aの終了で満7年が経過した。

2. ビームライン・実験装置の概要^[2]

BL16B2の基本仕様は、表1の通りである。実験ハッチ内 には大型定盤が設置され、その上に3台のゴニオメータを 配備し、XAFS測定、X線トポグラフィや反射率測定など の精密X線光学実験を行うことができる(ビームラインの 配置図は前章BL16XUの図1に示す)。

光源	偏向電磁石
光子エネルギー	4.5keV~113keV
単色器	可変傾斜型二結晶 (Si(111)、Si(311)、Si(511))
光子数	$\sim 10^{10}$ photons/s
ビーム径	0.1mm(H)×~0.1mm(V)ミラー使用 40mm(H)×~2mm(V)ミラー無し





触媒の研究では、使用状態を再現した環境下で結合状態 を解析することが必須となる。このような用途を想定し、 2005年度に「その場計測ガス供給排気設備」を導入した。 これは、COやH₂S等の毒性ガス、H₂やCH₄等の可燃性ガ スを測定試料室に導入することを可能とするものである。 排気ラインには吸着剤からなる除害設備を設け、環境にこ れらのガスが飛散することを防止している。これにより、 主にXAFS法による触媒等のその場計測が可能となった。

3. 利用の状況

BL16ではユーザータイムを各社均等に配分している。 2005年度はユーザータイムの約80%を各社利用に供してい る。これは、ほぼ例年通りであり、各社の利用時間は約10 日/年となっている。

装置別の利用割合を図1に示すが、XAFS測定が90%近 くを占めていることがわかる。一方、図2に利用テーマの 割合を示すが、半導体・素材・電池・触媒等の分野でほぼ 均等に利用されている。これらのことは、XAFS法が産業 利用の様々な分野で必須の技術であることを示すものと考 えられる。

4. 主な研究成果

BL16XU/B2成果報告会(サンビーム研究発表会)を



[注1] 神戸製鋼所、三洋電機、住友電気工業、ソニー、電力グループ(関西電力、電力中央研究所)、東芝、豊田中央研 究所、日本電気、日立製作所、富士通研究所、富士電機アドバンストテクノロジー、松下電器産業、三菱電機(50音順) 2001年から開催しており、本年度は第5回目をとして2005 年9月5日~6日に開催した^[3,4]。この発表会の詳細につい ては前章BL16XUを参照されたい。

以下にBL16B2を利用した研究成果について紹介する。

2005年9月に稼動した「その場計測ガス供給排気設備」 を用いることで、 CO_2 の水素化反応でメタノールを合成す る CuO-ZnO-Al₂O₃触媒の解析が行われている。 CuO/ZnO/Al₂O₃=100/50/2.5の触媒に対し、還元前処理 (200℃、1.01vol%H₂-N₂、大気圧)及びそれに引き続くメタ ノール合成反応中(250℃、14.5vol%H₂-5.1vol%CO₂-N₂、 0.87MPa)の銅の化学状態がin-situ XAFSにより追跡された。 図3に示す銅周辺動径関数から、還元前処理開始後69分後 には完全にメタル化していることや、メタノール合成中に 銅メタル粒子の成長は見られないことなどがわかった^[5]。

XAFS利用では上記のガス導入以外にも種々のin-situ実



図3 CuO-ZnO-Al₂O₃触媒中の銅周辺動径関数。

験が行われている。燃料電池動作時に形成される表面酸化 物の詳細な構造解析を目指して、電位制御下でのin-situ XAFS解析が行われ、電位の上昇とともに、表面酸化物が 形成されていく過程を捉えることに成功した。0.8~1.0V の電位領域では、表面酸素種の吸着、1.0~1.1Vでは、Pt-O酸化物が、1.2V以上ではPtO₂に近いアモルファス状の酸 化物が形成されていることが明らかとなった。表面酸素種 や酸化物の構造が明らかとなったことで、触媒活性と表面 構造の関係を明らかにすることが可能になるものと期待さ れる^[6]。

環境分析関係の実験もなされている。2006年7月に欧州 で施行されたいわゆる「RoHS指令」により、電気電子部 品中にCr⁶⁺等の有害元素の使用が禁止された。Cr⁶⁺につ いては水溶液に抽出して発色させた後に吸光光度測定で定 量化する手法が一般に採られている。しかしメッキ皮膜か らCr⁶⁺が完全に抽出されているか確認することが困難であ った。今回、7素子シリコンドリフト検出器(SDD)を用 いたXANES測定によりクロムメッキ皮膜中の微量Cr⁶⁺の 有無を確認することが出来た。即ち、一般的なFe基材上 Znめっき後のクロメート処理膜では従来の熱水抽出法で はCr⁶⁺が残存するが、新規に開発した水酸化リチウム抽出 法ではCr⁶⁺がほぼ100%抽出されることが確認できた^[7]。



図4 CrのK-XANES pre edgeピークによるCr⁶⁺残存量の比較。 5992eV付近のピークはCr⁶⁺に特有。

リチウムイオン二次電池の正極材料として有望視されて いるLixMnyFe_{1-y}PO₄オリビンは、Mn含有量の高い組成 で十分な電池特性が得られなかった。今回、活物質作製法 の最適化により、y=0.75と言うMn含有量の大きな領域で も良好な充放電特性が得られた。図5に示すMn周りの第 一近接酸素に起因するピーク(1.6Å位置)は、充電により 初期状態から0.2Åほど短距離側にシフトするが、その強度



図5 Li_xMn_{0.75}Fe_{0.25}PO₄のMn周りの動径構造関数。

は80%以上の高さで維持された。すなわち、充電で、ヤー ンテラーイオンであるMn³⁺が生じるにもかかわらず、Mn 周りの局所構造の歪みは大きくないことがわかる。充放電 に対する局所構造の安定性は活物質の作製法にも依存し、 充電状態のMn³⁺の周りの局所構造の歪みが大きくないこ とが、良好な電池特性につながったと考えられる^[8]。

光通信においては、信号増幅を行うことが必要不可欠で あり、これにはEDFA(Er-doped optical fiber amplifier) が用いられている。一方、高速・大容量通信のニーズに応 えるため、WDM(Wavelength division multiplexing)技 術が用いられており、EDFAには更なる高帯域化が求めら れている。このため、EDFの発光特性を支配するErの局 所構造解析が実施された。その結果、共添加するAl濃度 が高くなるに従い、Er-O配位数が大きく、増幅ゲインが 平坦化することが明かとなった^[9]。

微量な物質の化学形態分析においては、7素子シリコン ドリフト検出器(SDD)による蛍光XAFS法が有効であり、 多様な形態で混在するppmオーダーの微量物質の化学形 態を特定する技術が開発された。図6に示すように、溶液 中に含まれる10mg/kg(10ppm)レベルの希薄な亜セレン 酸イオンが時間経過と共にセレン酸イオンに酸化される過 程を捉えることに初めて成功している。この手法は、反応 過程におけるイオン種の状態や挙動変化を調べる上で有効 であり、酸化・還元剤の開発や反応気孔の解明への適用が 期待できる^[10]。

BL16B2ではイメージング実験も行われている。単色X 線トポグラフィにより、RAF (repeated a-face) 成長法



図6 亜セレン酸の酸化過程におけるXAFSスペクトルの変化と 構造。時間の経過とともに亜セレン酸(SeO₃²⁻)からセレ ン酸(SeO₄²⁻)の形状に徐々に変化している。

を用いて作製した4H-SiC単結晶の結晶性及び転位の詳細 な解析が実施された。結晶性の評価により、RAF基板は 世界最高品質のSiC単結晶基板であることが証明された。 また転位の詳細な解析は、高輝度な放射光と高品質な試料、 両者があって初めて可能となった。底面内転位と呼ばれる 転位は11-20方向に平行ならせん転位であり、c軸方向の転 位は純粋ならせん転位ではないことを明らかにした。SiC 単結晶中の転位の低減には、転位の詳細な構造の情報は重 要である。高信頼性のSiCデバイス実現に向け転位低減が 必要であり、今回の結果は重要な情報である^[11]。

> 住友電気工業(株) 解析技術研究センター 山口浩司

参考文献

- [1] 泉弘一 他: SPring-8利用者情報 4 (1999) 20; 久保佳 実: ibid. 6 (2001) 103.
- [2] 第13回日本放射光学会年会(2000/1/8、岡崎)で報告.
- [3] 産業用専用ビームライン建設利用共同体編集・発行
 「第5回サンビーム研究発表会(第2回SPring-8産業利用 報告会)報告書」.
 http://sunbeam.spring8.or.jp/

[4] 廣沢一郎: SPring-8利用者情報 6 (2005) 383.

- [5] SPring-8 User Experiment Report No.15 (2005A) 262.
- [6] H. Imai, et al.: Materials Integration, **19** (2006) 7.
- [7] 立部哲也 他:日本分析化学会第54年会講演予稿集 p79 C3019 (2005年9月16日).
- [8] G. Li et al.: J. Electrochem. Soc. **149** (2002) A1414.
- [9] T. Haruna et. al.: OFC2005 (20053/11, Anaheim, California, USA);春名 他:電子情報通請学会(2005/3/25、国士 舘大学);飯原 他:応用物理学会(2005/3/25、武蔵工 大);飯原 他:電子情報通信学会 光ファイバ応用技 術研究会(2006/5/11、九州大学); T.Haruna et al.: Optics Express, accepted.
- [10] 山本 他:電力中央研究所報告(Q04009)(2005).;秋保 他:第5回サンビーム研究発表会、2005/09.
- [11] 山口聡 他: SPring-8 News No.20 (2005.5); S. Yamaguchi et al.: SPring-8 Research Frontiers 2004 (2005) pp.129-130; D. Nakamura: "Reduction of Dislocations in the Bulk Growth of SiC Crystals", ICSCRM 2005 (International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2005), Sep (2005) 18-23, Pittsburgh, USA; S. Yamaguchi et al.: "The Synchrotron X-ray Topographic Analysis of Dislocation Structure in Bulk SiC Single Crystal", ICSCRM 2005 (International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2005), Sep (2005) 18-23, Pittsburgh, USA; Sep (2005) 18-23, Pittsburgh, USA.